

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2009年8月13日(13.08.2009)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2009/099191 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/301 (2006.01) H01L 21/52 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01) H01L 25/065 (2006.01)
C09J 201/00 (2006.01) H01L 25/07 (2006.01)
H01L 21/304 (2006.01) H01L 25/18 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2009/052075
- (22) 国際出願日: 2009年2月6日(06.02.2009)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2008-028220 2008年2月7日(07.02.2008) JP
特願 2008-085439 2008年3月28日(28.03.2008) JP
特願 2008-167547 2008年6月26日(26.06.2008) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社(SUMITOMO BAKELITE COMPANY LIMITED) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川2丁目5番8号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 平野 孝(HIRANO, Takashi) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川2丁目5番8号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 朝比 一夫, 外(ASAHI, Kazuo et al.); 〒1050003 東京都港区西新橋1丁目18番9号 西新橋ノアビル4階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: FILM FOR SEMICONDUCTOR, METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE AND SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 半導体用フィルム、半導体装置の製造方法および半導体装置

[図1]

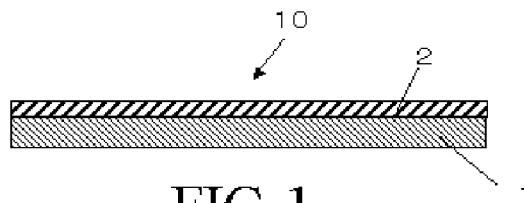


FIG. 1

(57) Abstract: Disclosed is a film for semiconductors, which comprises a sheet base and an adhesive layer formed on one side of the sheet base. The film for semiconductors is characterized in that the adhesive layer is composed of a resin composition containing a crosslinkable resin and a compound having flux activity. This film for semiconductors is preferably used in such a manner that the adhesive layer of the film for semiconductors is in contact with a function surface of a flip chip semiconductor device.

(57) 要約: 本発明の半導体用フィルムは、シート基材と、該シート基材の一方の面側に設けられた接着剤層とを有するものであり、前記接着剤層が、架橋反応可能な樹脂およびフラックス活性を有する化合物を含む樹脂組成物で構成されていることを特徴とする。また、本発明の半導体フィルムは、フリップチップ型の半導体素子の機能面と、前記半導体用フィルムの前記接着剤層とを接着させて用いるのが好ましい。



WO 2009/099191 A1